

HRGP-4170CTI PP

G/F Type	R/C	Thickness		Dk				Df			
		mm	mil	1GHz	2GHz	5GHz	10GHz	1GHz	2GHz	5GHz	10GHz
1080	65%	0.073	2.89	4.50	4.50	4.45	4.42	0.013	0.013	0.014	0.015
1080	66%	0.076	3.01	4.49	4.49	4.44	4.41	0.013	0.013	0.014	0.015
1080	68%	0.082	3.22	4.46	4.46	4.41	4.38	0.013	0.013	0.014	0.015
1080	70%	0.088	3.46	4.44	4.44	4.39	4.36	0.013	0.013	0.014	0.015
2313	58%	0.100	3.94	4.61	4.61	4.56	4.53	0.013	0.013	0.014	0.015
3313	58%	0.100	3.94	4.61	4.61	4.56	4.53	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	55%	0.119	4.70	4.65	4.65	4.60	4.57	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	57%	0.126	4.96	4.62	4.62	4.57	4.54	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	58%	0.130	5.10	4.61	4.61	4.56	4.53	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	60%	0.137	5.38	4.59	4.59	4.54	4.51	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	62%	0.146	5.75	4.57	4.57	4.51	4.48	0.013	0.013	0.014	0.015
2116	63%	0.150	5.91	4.56	4.56	4.50	4.47	0.013	0.013	0.014	0.015
7628	45%	0.188	7.40	4.83	4.83	4.78	4.75	0.012	0.012	0.013	0.014
7628	47%	0.197	7.76	4.80	4.80	4.75	4.72	0.013	0.013	0.014	0.015
7628	48%	0.202	7.95	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
7628	50%	0.212	8.35	4.75	4.75	4.70	4.67	0.013	0.013	0.014	0.015
7628	52%	0.223	8.77	4.72	4.72	4.67	4.64	0.013	0.013	0.014	0.015
7630	50%	0.221	8.70	4.75	4.75	4.70	4.67	0.013	0.013	0.014	0.015
7630	52%	0.232	9.13	4.72	4.72	4.67	4.64	0.013	0.013	0.014	0.015

备注：不在以上规格，可评估定制；由于CTI600PP的CTI值与RC和奶油层厚度相关。厚度2116以下型号RC低于55%；7628RC<46%的PP，其CTI可能达不到600V，请使用前咨询。

HRG-4170CTI CCL

Thickness		G/F Type	R/C	Dk				Df			
mm	mil			1GHz	2GHz	5GHz	10GHz	1GHz	2GHz	5GHz	10GHz
0.2	8	1*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
0.25	10	2*2116	57%	4.62	4.62	4.57	4.54	0.013	0.013	0.014	0.015
0.3	12	2*1506	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
0.4	16	2*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
0.5	20	2*7628+1* 2116	50%	4.75	4.75	4.70	4.67	0.013	0.013	0.014	0.015
0.6	24	3*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
0.7	28	2*7628+2* 7627	43%	4.87	4.87	4.82	4.79	0.012	0.012	0.013	0.014
0.8	31	4*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
0.9	35	5*7628	43%	4.87	4.87	4.82	4.79	0.012	0.012	0.013	0.014
1.0	39	5*7628	46%	4.81	4.81	4.76	4.73	0.012	0.012	0.013	0.014
1.1	43	6*7628	44%	4.85	4.85	4.80	4.77	0.012	0.012	0.013	0.014
1.2	47	6*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015
1.5	59	8*7628	45%	4.83	4.83	4.78	4.75	0.012	0.012	0.013	0.014
1.6	63	8*7628	48%	4.79	4.79	4.74	4.71	0.013	0.013	0.014	0.015

备注:

- 1、上表中31mil(不含)以下厚度为不含铜厚度, 31mil(含)以上规格含铜厚度(以H/H铜箔为基准)。
- 2、上表中DK(1G)为基板绝缘层检测数据(基于IPC-TM-650 2.5.5.9量测), 与PCB阻抗使用之反推Dk有所差异, 不可直接使用。
- 3、状态栏空白表示有生产经历, 但非常用量产规格。